

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-75

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>上市公司网上集体接待日</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	投资者网上提问
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：张丽君；总会计师：楼志勇；独立董事：于洪宇
时间	2024年12月12日
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
形式	线上交流
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p>公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复：</p> <p><b>Q1、请问深南电路在2024年上半年如何优化产品结构，以及这种优化对公司利润的提升有何贡献？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。2024年上半年，公司实现归母净利润9.87亿元，同比增长108.32%。一方面主要受益于公司加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长，三项主营业务收入均实现同比增长。另一方面，公司紧抓AI的加速演进及应用深化等机会，产品实现结构优化，助益利润同比提升。谢谢关注。</p> <p><b>Q2、您好，请您分析一下，2025年公司的发展和困难，是否有新的利润增长点，公司的业绩是否能保持增长，谢谢您。</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。随着集成电路技术和下游电子行业的发展驱动着PCB（含封装基板）技术的不断进步，代表未来产业方向的人工智能、下一代通信、数据中心、汽车电子等</p>

领域将对 PCB 技术提出更高要求，高速、高频和高系统集成将成为电子电路行业未来的主要发展方向。公司将主动把握行业机遇，发挥 40 年深耕电子互联领域行业经验优势，积极应对市场竞争与高阶产品技术的挑战，依照既定的发展战略及经营策略做好主业，推动公司实现更高质量发展，努力回报广大投资者。感谢您的关注。

**Q3、深南电路如何评估当前原材料价格波动对公司未来盈利能力的影响？**

尊敬的投资者，您好。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等，涉及品类较多，就公司成本端而言，2024 年上半年，铜箔、覆铜板等关键原材料价格随大宗商品价格波动，贵金属等部分辅材价格出现一定涨幅，部分板材价格在二季度末以来有所上浮，整体价格相对保持平稳。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况，并与供应商及客户保持积极沟通。感谢您的关注。

**Q4、你好，请问公司产品在量子计算机中有应用吗？另外公司有没有在软件开发中涉足呢？**

尊敬的投资者，您好。公司拥有印制电路板、电子装联和封装基板三项主营业务，下游应用领域广泛，覆盖通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域，目前不涉及题述领域业务。感谢您的关注。

**Q5、广州工厂目前有订单吗？**

尊敬的投资者，您好。公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，目前尚处于产能爬坡前期阶段，已承接部分产品订单。感谢您的关注。

**Q6、张总，根据《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》，到 2027 年底，每万人拥有 5G 基站数将达到 38 个。而目前的数据是每万人拥有 5G 基站数为 28 多点，仍有不小差距。请问这个行动方案有助于公司通信业务的改善。**

尊敬的投资者，您好。公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年前三季度，通信市场不同领域需求分化较大，其中无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求在 AI 相关需求的带动下有所增长，助益公司通信领域 PCB 产品结构优化，盈利能力有所改善。公

司将持续关注通信产业发展趋势及前沿动态。感谢您的关注。

**Q7、无论是封装基板的研究还是海外工厂的建设，贵公司一直是跟随行业趋势，目前沪电股份成立了专门针对人工智能业务的事业部，贵公司是否评估过有无跟随的必要性。或者说在人工智能领域，贵公司已经找到了更好的发力点或者规划，是否可以细节披露一下？谢谢。**

尊敬的投资者，您好。伴随人工智能技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。公司将持续密切关注行业相关机会。感谢您的关注。

**Q8、请问公司在航电领域有哪些产品布局？**

尊敬的投资者，您好。公司拥有印制电路板、电子装联和封装基板三项主营业务，下游应用领域广泛，覆盖通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等领域。其中部分产品应用于国际航电市场，目前该部分业务占比较小。公司对题述领域前沿技术及应用场景保持关注与研究，感谢您的关注。

**Q9、楼总，从兴森科技的 FC-BGA 的研发进程看，目前已经进入了大额费用摊销阶段。再结合贵公司的 FC-BGA 的研发进度，您是否可以预期深南电路此业务大额费用摊销时段，是否可以向投资者说明。谢谢。**

尊敬的投资者，您好。广州封装基板项目已于 2023 年第四季度连线投产，产品线能力持续快速提升，目前处于产能爬坡前期阶段。公司 FC-BGA 封装基板现已具备 16 层及以下产品批量生产能力，16 层以上产品具备样品制造能力，其中 20 层产品送样认证工作亦有序推进中。公司相关生产设备达到预定可使用状态后分批转固。谢谢关注。

**Q10、但凡机构或投资者调研，回答都是千篇一律，每次调研公告发后，股价就下跌一个台阶，为什么？**

尊敬的投资者，您好。公司的基本情况通常在一段期间内保持稳定，各投资机构关注的

公司基本情况、经营发展近况等存在较多共性的内容。调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，及时披露投资者关系活动记录表。二级市场股票价格通常受到多方面因素影响。公司将继续做好主业，努力实现稳健经营，努力以良好的业绩回报广大股东。感谢您的关注。

**Q11、公司三季报显示，应收账款与去年同期增加 10 亿，同时应付账款增加 8 亿，为什么？四季度公司整体经营收入增速有无提升？**

尊敬的投资者，您好。公司把握 2024 年以来行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，报告期内订单同比增长，应收账款、应付账款对应有所增加。公司严格按照监管要求进行信息披露工作，关于尚未披露的业绩情况请您留意后续公告，谢谢。

**Q12、公司三季报显示，应收账款与去年同期增加 10 亿，同时应付账款增加 8 亿，为什么？四季度公司整体经营收入增速有无提升？**

尊敬的投资者，您好。公司把握 2024 年以来行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，报告期内订单同比增长，应收账款、应付账款对应有所增加。公司严格按照监管要求进行信息披露工作，关于尚未披露的业绩情况请您留意后续公告，谢谢。

**Q13、深南电路在数据中心领域的产品布局有哪些新进展，以及这些进展对公司业绩的影响如何？**

尊敬的投资者，您好。数据中心是公司 PCB 业务重点布局领域之一，聚焦服务器、存储及周边产品。2024 年前三季度，全球主要云服务厂商资本开支规模明显回升，并重点用于算力投资，带动 AI 服务器相关需求增长，叠加通用服务器 Eagle Stream 平台迭代升级，服务器总体需求回温。在此期间，公司数据中心领域订单同比显著增长，主要得益于 AI 加速卡、Eagle Stream 平台产品持续放量等产品需求提升，产品结构有所优化。在新产品预研方面，公司已配合下游客户开展下一代平台产品研发、打样工作。感谢您的关注。

**Q14、深南电路如何应对当前电子行业竞争格局的变化，公司有哪些竞争优势？**

尊敬的投资者，您好。PCB 行业下游应用领域广泛，集中度较低，且市场竞争较为激烈。伴随近年行业头部企业的新增产能逐步释放，PCB 行业的市场竞争正逐步加剧。公司在

技术能力储备、客户资源积累、产能规模以及采购能力等多方面均具有行业竞争优势，公司将依照既定的整体发展战略及经营策略，不断强化产品技术领先优势，持续提升管理运营能力，打造运营、质量、管理的核心竞争优势，加快设计及产品开发等领域的发展速度，打造优势产品，形成新的增长点，持续为客户提供增值服务，积极应对市场竞争。谢谢关注。

**Q15、深南电路在 2024 年上半年在通信设备领域的 PCB 产品销售情况如何？**

尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2024 年上半年，通信市场不同领域需求分化较大，无线侧通信基站相关产品需求未出现明显改善，有线侧 400G 及以上的高速交换机、光模块产品需求在 AI 相关需求的带动下有所增长，助益公司通信领域 PCB 产品结构优化，盈利能力有所改善。谢谢关注。

**Q16、请问深南电路在 2024 年上半年对于智能化、自动化等新技术在 PCB 生产中的应用有哪些新的探索和实践？**

尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，公司深入推进数字化转型工作，深化落实制程、运营、流程、设备、产品等维度的数字化全面建设，重点提升了各监控指标的透明化与可视化，其中对产品关键制程透明化覆盖率已达 90%以上，确保在实时监控过程中及时发现风险点，进一步提升质量管理能力和生产经营效率。另一方面，公司积极采用虚拟仿真、智能化柔性制造、能源管理系统等一系列数字化技术，在提升业务生产效率的同时监控管理能耗，有效降低了生产过程中的碳排放，有助于推进公司实现可持续高质量发展。谢谢您的关注。

**Q17、请问深南电路 2024 年上半年在汽车电子领域实现了哪些具体的市场拓展成果？**

尊敬的投资者，您好。汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一，主要面向海外及国内 Tier1 客户，以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向。2024 年上半年，公司 PCB 业务在汽车电子领域继续重点把握上述方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，智能驾驶相关高端产品需求稳步增长，推动汽车电子领域业务占比提升。谢谢您的关注。

**Q18、请介绍深南电路在 2024 年上半年对新产品研发的投入情况及其对公司产品线的贡献。**

	<p>您好。2024 年上半年，公司研发投入 6.39 亿元，同比增长 69.74%，研发投入占报告期营收比重为 7.68%，同比提升 1.44 个百分点。公司在通信、数据中心及汽车电子相关 PCB 技术研发，FC-BGA 基板产品能力建设，FC-CSP 精细线路基板和 RF 射频基板技术能力提升等研发项目均按期稳步推进，为公司后续开发新产品新项目完善了技术储备。谢谢。</p> <p><b>Q19、深南电路在 2024 年上半年在国内外市场拓展方面有哪些新策略，成效如何？</b></p> <p>尊敬的投资者您好。2024 年上半年，公司积极把握 AI 加速演进、汽车电动化/智能化趋势延续以及服务器等部分领域需求修复等机会，加大各业务国内外市场开发力度，推动产品结构进一步优化。同时，公司加快对新产品和新客户导入进度，为后续发展打下基础。谢谢。</p> <p><b>Q20、深南电路在 2024 年上半年采取了哪些措施来提升产能稼动率，这些措施的效果如何？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。2024 年上半年，电子产业受益于 AI 带来的算力需求爆发以及周期性的库存回补，需求略有修复。在此期间，公司积极把握行业结构性机会，加大各项业务市场拓展力度，订单同比增长。同时，公司积极推进数字化转型工作，助益生产经营效率提升。得益于上述背景及举措，2024 年上半年公司产能稼动率保持在良好水平，三项主营业务收入均实现同比增长，产品结构实现优化，利润同比提升。谢谢。</p> <p><b>Q21、你好，请问 1.公司有无回购公司股份计划。2.公司第四季度的产能及销售情况。谢谢。</b></p> <p>尊敬的投资者，您好。如有相关计划，公司将按规定履行审批程序及信息披露义务。公司近期综合产能利用率较 2024 年第三季度保持平稳，各业务销售情况正常。谢谢您的关注。</p>
<p><b>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</b></p>	<p>调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p><b>附件清单</b></p>	<p>无</p>